

2025 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名 トレックス・セミコンダクター株式会社  
代 表 者 名 代表取締役 木 村 岳 史  
社長執行役員  
(コード番号：6616 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役 執行役員 前 川 貴  
経営企画本部 本部長  
(TEL. 03-6222-2875)

上場維持基準への適合に向けた計画（改善期間入り）について

当社は、2025年3月31日時点において、プライム市場における上場維持基準に適合しない状態となりました。下記のとおり、上場維持基準への適合に向けた計画を作成しましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 当社の上場維持基準への適合状況、計画期間及び改善期間

当社の 2025 年 3 月 31 日時点における東京証券取引所プライム市場の上場維持基準への適合状況は、下表のとおりとなっており、流通株式時価総額基準については基準を充たしておりません。

当社は、今回不適合となった流通株式時価総額基準を充たすために、上場維持基準への適合に向けた各種取組みを進めてまいります。なお、流通株式時価総額基準について、2026 年 3 月 31 日までの改善期間内に適合していることが確認できなかった場合には、東京証券取引所より監理銘柄（確認中）に指定されます。その後、当社が提出する 2026 年 3 月 31 日時点の分布状況表に基づく東京証券取引所の審査の結果、流通株式時価総額基準に適合している状況が確認されなかった場合には、整理銘柄に指定され、当社株式は 2026 年 10 月 1 日に上場廃止となります。

|                  | 株主数         | 流通株式<br>数      | 流通株式<br>時価総額    | 流通株式<br>比率 | 1 日平均<br>売買代金 | 純資産の額       |
|------------------|-------------|----------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| 当社の状況<br>(基準日時点) | 3,842 人     | 66,611<br>単位   | 81.2 億円         | 57.6%      | 5,176<br>万円   | 174 億円      |
| 上場維持基準           | 800 人<br>以上 | 20,000<br>単位以上 | 100 億円<br>以上    | 35%以上      | 2 千万円<br>以上/日 | 純資産の<br>額が正 |
| 計画期間<br>(改善期間)   |             |                | 2026 年<br>3 月末日 |            |               |             |

※ 当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行ったものです。

## 2. 上場維持基準の適合に向けた取組みの基本方針、課題及び取組み内容

## (1) 基本方針

上場維持基準の未達項目である「流通株式時価総額」の充足に向けて、収益性を改善することを背景として株価を上昇させ、「時価総額」を向上させることで、2026 年 3 月期末日までに未達項目の適合を目指します。

## (2) 課題及び取り組み内容

当社は、株主数、流通株式数、流通株式比率の基準を充たしておりますが、流通株式時価総額の基準を充たしておりません。流通株式時価総額の向上には、株価を向上させることが重要であると認識し、収益性を向上させることで株式市場から評価されるべく、以下の取り組みを推進してまいります。

### ① 主要事業の売上拡大

トレックス・セミコンダクター株式会社（以下、トレックス）では、DC/DC コンバータ及びコイル一体型 DC/DC コンバータの拡販を強化し、FAE（フィールド・アプリケーション・エンジニア）による技術支援により売上を拡大します。子会社フェニテックセミコンダクター株式会社（以下、フェニテック）は、汎用の小電力ディスクリット製品の拡販強化とパワー半導体デバイスにおいては、張り合わせ基板使用のオリジナル SiC の販売促進により売上を拡大します。

### ② 「強み」を生かした収益性改善

トレックスはトレックスのコアコンピタンスである「小型・省電力・低ノイズ」製品の販売を、フェニテックは主要化合物半導体デバイスの受託生産を強化することで収益性を改善します。また、社内改善活動により、経費低減を行います。

### ③ 非財務面における情報開示、人的資本経営を意識した取り組み

当社は前年度において、サステナビリティ基本方針とマテリアリティを定め、公表いたしました。当該マテリアリティのうち「多様で個性ある人財が活躍できる環境の整備」について、人的資本経営を意識した取り組みを基本方針に従い進めると共に、今年度も引き続き、情報開示を進めてまいります。

### ④ 新中期経営計画について

現在、全社を挙げて 2026 年度から始まる新中期経営計画の策定中です。2025 年 11 月に新中期経営計画を発表する予定です。当社グループの中核ビジネスと成長戦略の議論を深め、収益性の改善と成長の蓋然性を示してまいります。

### ⑤ IR 活動の取り組み

積極的な IR 活動により、既存株主・投資家との関係性の深化、及び新規株主・投資家からの投資促進を目指します。

### ⑥ 株主還元について

配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として連結配当性向 20%以上、安定的かつ継続的な株主還元の拡充として株主資本配当率（DOE）3%程度を継続します。

以 上

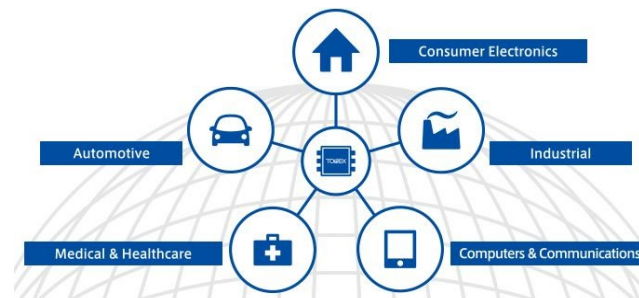
# 東証プライム市場の上場維持基準の 適合に向けた計画書

2025年 6月 13日

トレックス・セミコンダクター株式会社

世界は「アナログ」でできている

あらゆるフィールドで活躍するトレックスの電源IC



1

プライム上場維持基準の適合状況

2

現状の把握

3

適合に向けた基本方針

4

改善に向けた具体的な取り組み

5

中期経営計画について

6

IR活動の取り組み、株主還元、その他

Appendix

# 1. プライム上場維持基準 適合状況

当社は、2025年3月31日時点において、東京証券取引所プライム市場における上場維持基準について、下記のとおり不適合が生じておりますことをお知らせいたします。

上場維持基準6項目のうち5項目は充たしているものの、「流通株式時価総額」が81.2億円と基準値100億円以上を充たしておりません。

当社は、流通株式時価総額の基準に関し、上場維持基準を充たすべく、各種取り組みを進めてまいります。

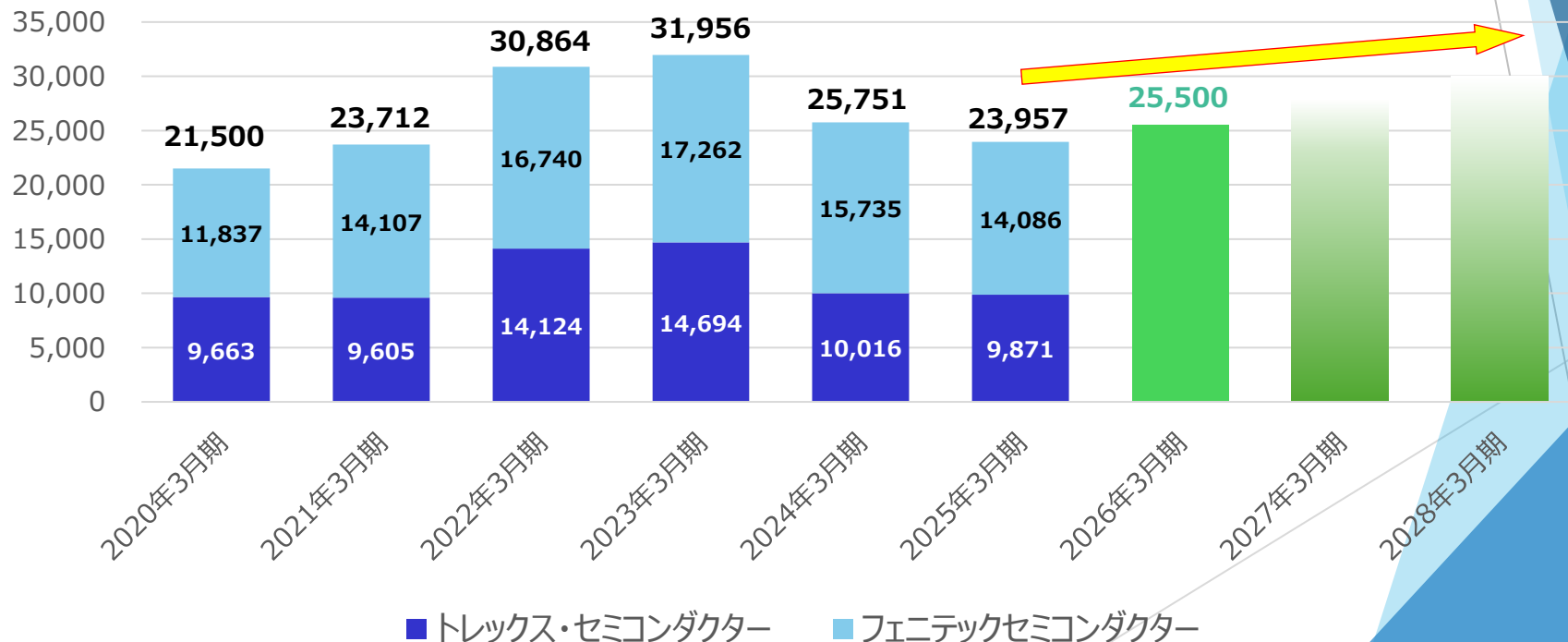
|                  | 株主数        | 流通株式数          | 流通株式時価総額    | 流通株式比率 | 1日平均売買代金     | 純資産の額       |
|------------------|------------|----------------|-------------|--------|--------------|-------------|
| 当社の状況<br>(基準日時点) | 3,842人     | 66,611<br>単位   | 81.2億円      | 57.6%  | 5千176万円      | 174億円       |
| 上場維持基準           | 800人<br>以上 | 20,000<br>単位以上 | 100億円<br>以上 | 35%以上  | 2千万円<br>以上／日 | 純資産の額が<br>正 |
| 適合状況             | 適合         | 適合             | 不適合         | 適合     | 適合           | 適合          |

## 2. 現状の把握 業績の推移

### 連結売上推移と今後の予測

⇒ 2022年3月期から2023年3月期にかけて、半導体不足が生じるほど、コロナ禍に起因した需要が拡大しましたが、2024年3月期以降は、その反動による在庫過多の調整が長引き、売上が低迷しました。

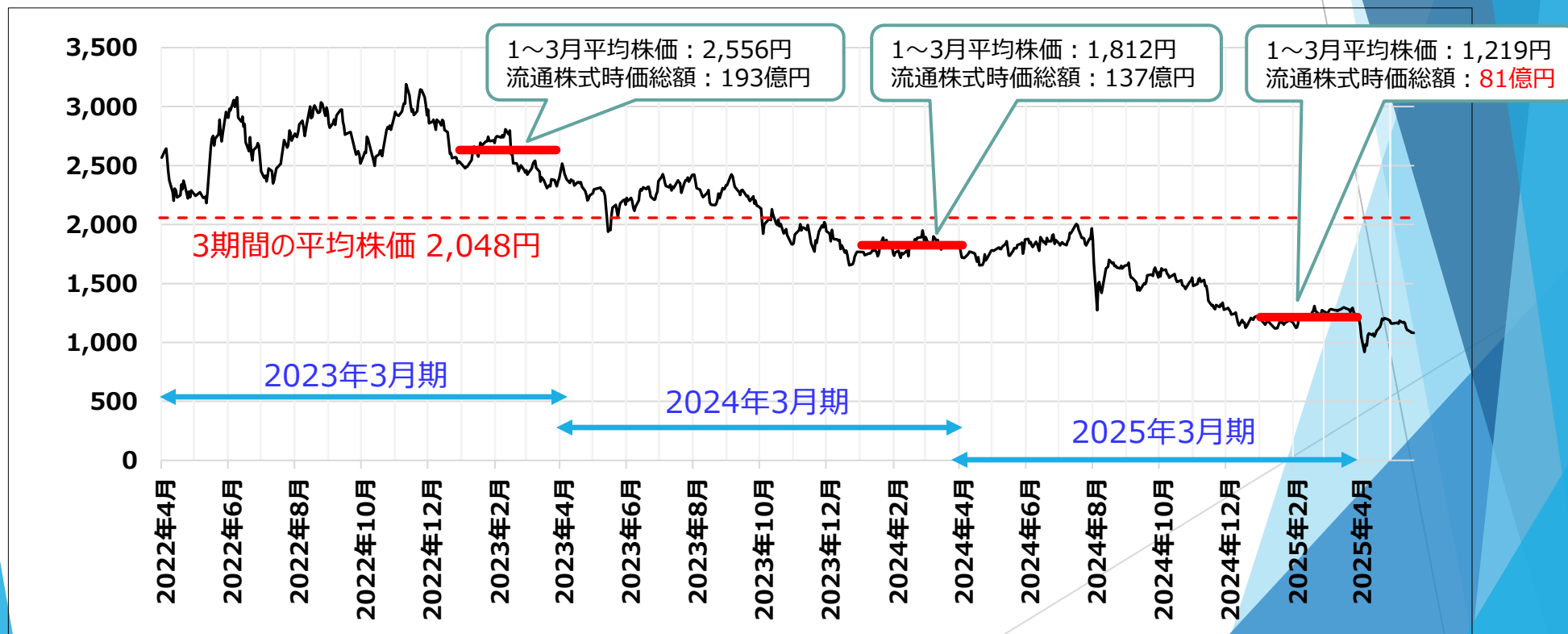
⇒ 足元では、市場の在庫調整も大方解消し、2025年以降は受注増が見込まれ、回復傾向に転じると想定しています。



## 2. 現状の把握 株価の推移

### 弊社株価推移

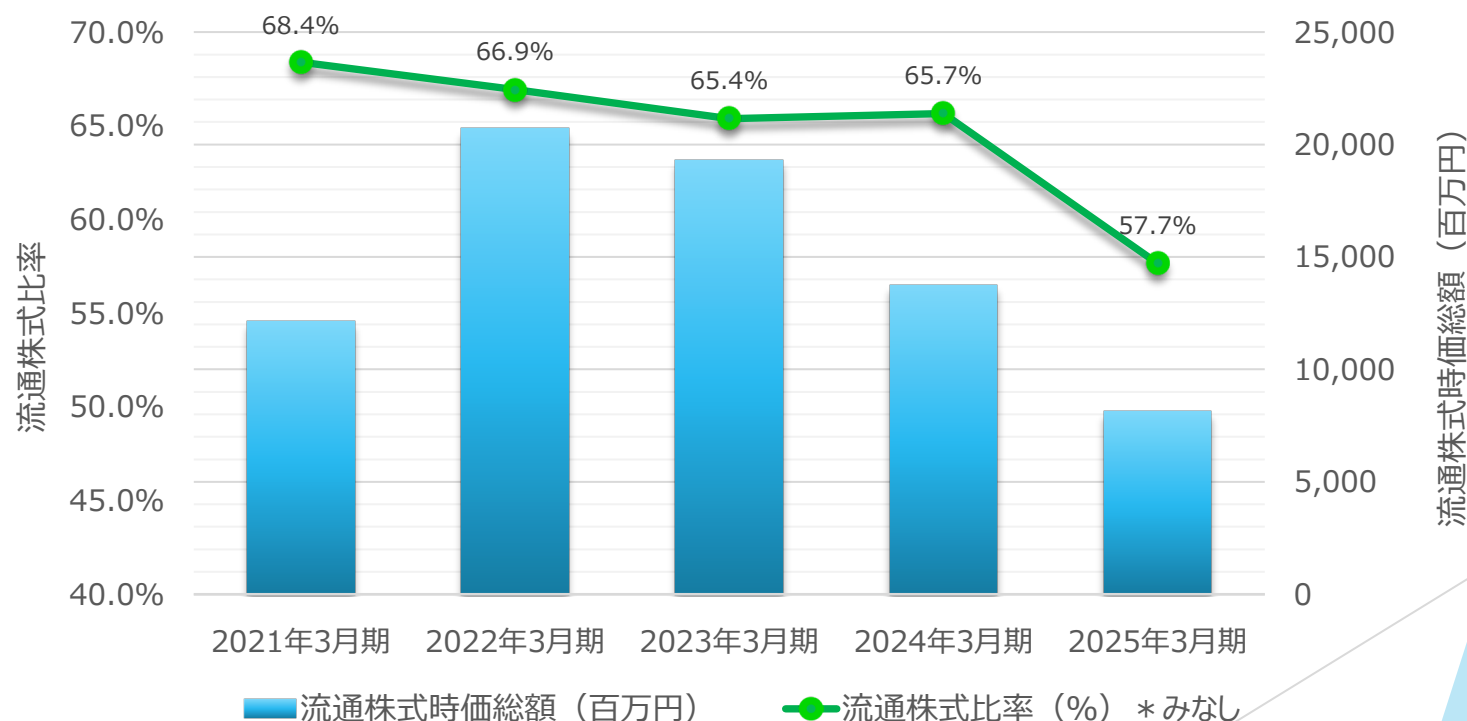
- ⇒ 2022年4月～2025年5月日次の当社株価の終値の推移です。  
同期間の平均は2,048円でした。
- ⇒ 2024年3月期以降、業績の悪化により、株価が下落が続いております。
- ⇒ 2025年1月～3月 流通株式時価総額が上場維持基準に抵触しました。



## 2. 現状の把握 流通株式比率の推移

### 流通株式比率

⇒ 当社の流通株式比率は上場維持基準に比して十分に高いものと考えます。  
⇒ しかしながら、2025年3月期は、以前と比較し流通株式比率が減少したことが、  
流通株式時価総額の低下の一因と捉えることができます。



### 3. 適合に向けた基本方針

時価総額

×

流通株式比率

=

流通株式時価総額

上場維持基準の未達項目である「流通株式時価総額」の充足に向けて、収益性を改善することを背景として株価を上昇させ、「時価総額」を向上させることで、2026年3月期末日までに未達項目の適合を目指します。

主要製品である電源ICの売上及びディスクリート製品のファウンドリ売上拡大による収入の拡大に注力するとともに、高付加価値製品の販売強化による収益率の改善、社内改善 活動による経費の低減を進め、収益性の向上を行います。

また、今年度中には2026年度から始まる新たな中期経営計画を策定し、中長期の成長戦略やサステナビリティ情報、資本コストを意識した経営に関する情報等の開示することで、株式バリュエーションの上昇にも取り組んでまいります。

## 4. 改善に向けた具体的な取り組み 収益性の改善

### 主要事業の売上拡大

#### ・ 電源IC（トレックス・セミコンダクター）

##### 製品群

- ⇒ 主力製品である、DC/DCコンバータの拡販強化
- ⇒ トレックス独自のコイル一体型DC/DCコンバータの拡販強化
- ⇒ FAE（フィールド・アプリケーション・エンジニア）による技術支援

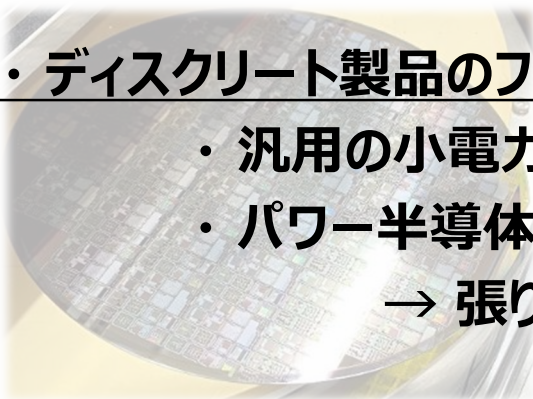
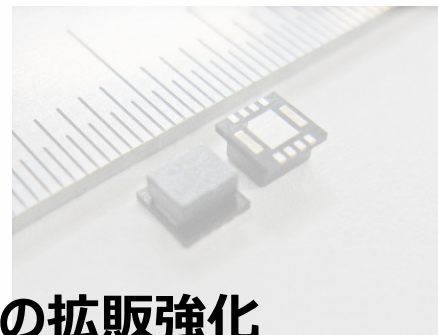
##### ターゲットマーケット

- ⇒ 産業機器分野、車載関連
- ⇒ AI機能搭載の電子端末（ノートPC等）、カメラモジュール、各種センサ

#### ・ ディスクリート製品のファウンドリ（フェニテックセミコンダクター）

- ・ 汎用の小電力ディスクリート製品
- ・ パワー半導体デバイスの拡販

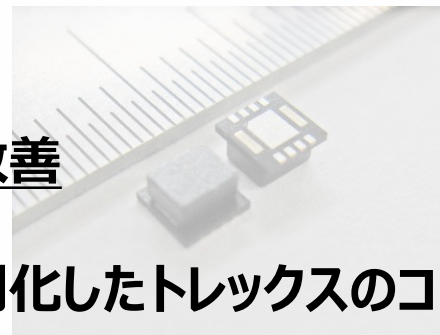
→ 張り合わせ基板使用のオリジナルSiCの販売促進



## 4. 改善に向けた具体的な取り組み 収益性の改善

### 「強み」を生かした収益性改善

#### ・ 高付加価値製品の販売強化により収益率の改善



「小型・省電力・低ノイズ」が他社と差別化したトレックスのコアコンピタンス

⇒ 中高耐圧DC/DCコンバータ

⇒ コイル一体型DCDCコンバータ XCLシリーズ

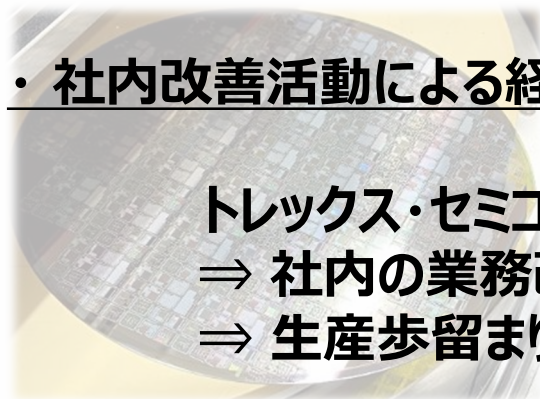
⇒ 超小型パッケージを利用した、汎用電源IC

主要化合物半導体デバイスのファウンドリをフレキシブルに受託可能

⇒ SiC、GaN、GaAs、Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

⇒ SiCファウンドリは、要素開発や試作フェーズも対応可能

#### ・ 社内改善活動による経費の低減



トレックス・セミコンダクター／フェニテックセミコンダクター 共通して

⇒ 社内の業務改善による一般販管費の抑制

⇒ 生産歩留まりの改善、工程削減、在庫縮小

## 4. 改善に向けた具体的な取り組み サステナビリティ



### 非財務面における情報開示について

当社は、2025年3月期において、サステナビリティ基本方針とマテリアリティを定め、公表いたしました。今後も引き続き、情報開示を進めてまいります。

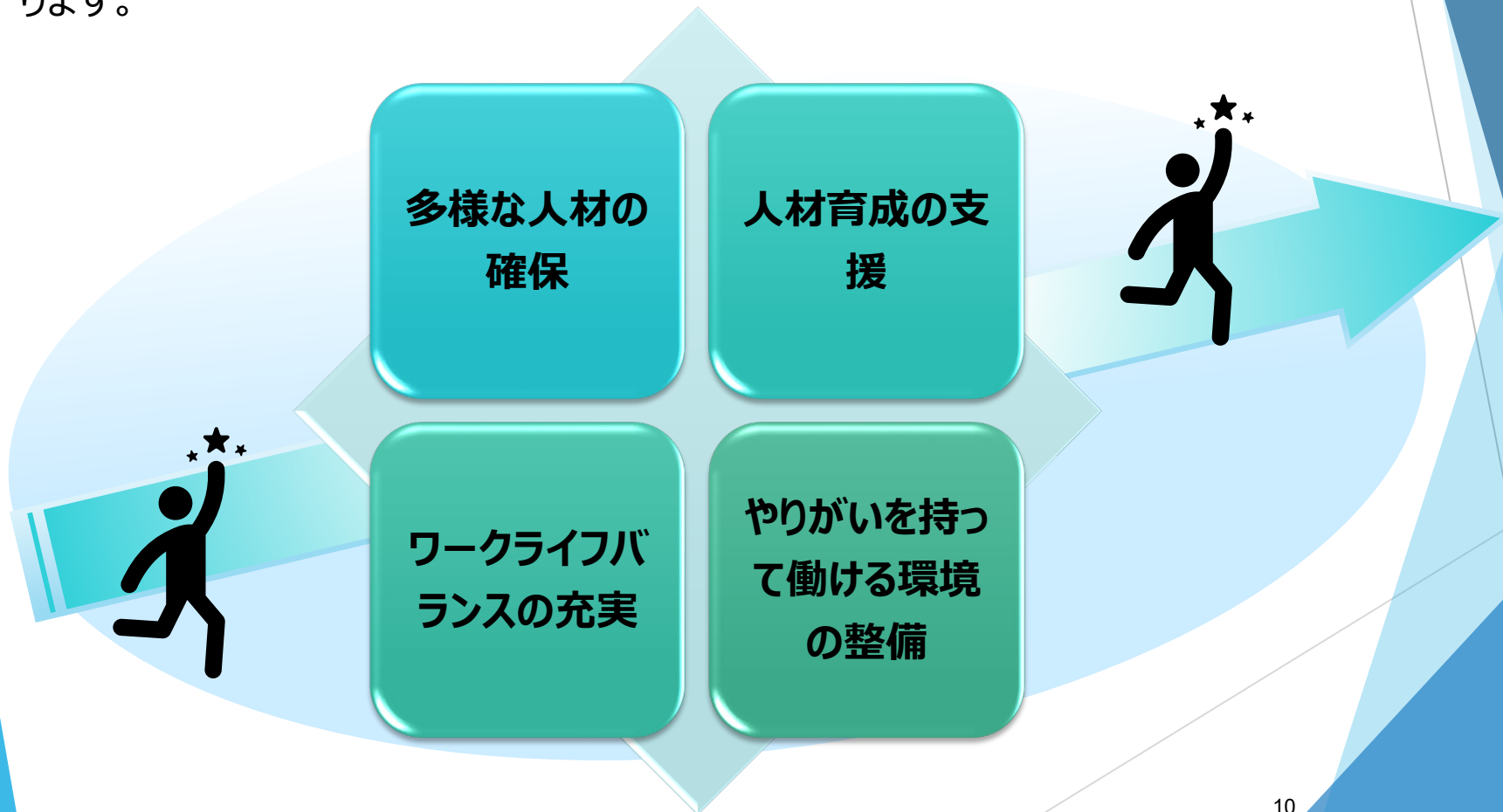
トレックスグループは、「価値ある製品を通じた豊かな社会の実現と地球環境の保全」を掲げ、環境・社会に貢献するという考えを経営の中心に据え、共存・共栄の精神で、すべてのステークホルダーとともにサステナビリティ推進に取り組んでまいります。

| マテリアリティ                 | 基本方針                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会課題解決に向けた高付加価値製品の提供    | トレックスグループの製品は、世界中のあらゆる分野で使用される電子機器に広く採用されています。持続可能な社会の実現に向け、高付加価値な半導体製品を提供することで、社会課題の解決と事業の成長の両立を目指しています。                                                              |
| 多様で個性ある人財が活躍できる環境の整備    | トレックスグループの強みは、長年にわたる半導体事業で培った技術力と、市場のニーズを的確に捉える力です。この力を次世代に継承し、急速に変化する時代に対応できる専門性と独創性を備えた組織力を構築するため、人財の確保と育成を推進していきます。また、多様な個性と専門性を活かし、従業員が自発的に活躍できる職場環境の整備にも注力していきます。 |
| 地球環境保全に向けた取組の推進         | トレックスグループは、気候変動を含む環境問題を、持続可能な社会の実現に向けた重要な課題と捉えています。バリューチェーンを通じて、環境負荷を軽減する半導体製品を提供することで、省エネや省資源化に貢献し、環境保全に取り組んでいきます。                                                    |
| すべてのステークホルダーのための経営基盤の確立 | トレックスグループは、事業に携わるすべてのステークホルダーが共に繁栄することを目指しています。グループの継続的な事業成長を通じて、社会に貢献し、利益の創出を実現していきます。中長期的な企業価値の向上に向け、堅実な経営基盤を維持し、リスクマネジメントを推進することで、さらなる成長を追求していきます。                  |

## 4. 改善に向けた具体的な取り組み 人的資本

### 人的資本経営を意識した取り組み

当社は、マテリアリティとして定めました「多様で個性ある人財が活躍できる環境の整備」について、人的資本経営を意識した取り組みを基本方針に従い進めてまいります。



## 5. 中期経営計画について

### 現行の中期経営計画

2022年3月期から始まった現行の中期経営計画は、2026年3月期に終了いたします。2026年3月期の売上350億円、営業利益40億円を目指しておりましたが、現在開示中の業績予想においては、未達となる見込みです。

### 新中期経営計画について

現在、トレックスグループ全社を挙げて2027年3月期から始まる新中期経営計画の策定中です。議論の内容として、

電源ICビジネス

ディスリート／パワー半導体デバイス

10年先を見据えた技術のブレークスルー

など、当社中核ビジネスと成長戦略の議論を深め、収益性の改善と成長の蓋然性を示してまいります。

### 発表時期

新中期経営計画の発表は、2025年11月を目途に予定しております。

## 6. IR活動の取り組み、株主還元、その他

### 積極的なIR活動

既存株主・投資家との関係性の深化、及び新規株主・投資家からの投資促進を目指します。

|                      | アクションアイテム                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開示項目の取り組み            | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 適時開示情報（短信、招集通知、適時開示）の英文開示の継続します。</li><li>・ 東証適時開示情報伝達システム（TDnet）を積極活用した発信機会を増やします。</li><li>・ 第2四半期、通期の決算発表時に開催しているweb決算説明会を継続して実施。<br/>当該説明会のインターネットでの動画配信を継続します。</li><li>・ 非財務面における情報（サステナビリティ情報）開示を充実します。</li></ul> |
| 経営目標等の開示             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 次期中期経営計画を策定し、11月を目途に開示予定です。</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
| コミュニケーション機会の増加と内容の充実 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 各メディアへの露出機会を増やすよう、活動してまいります。</li><li>・ 機関投資家向けIR個別面談（1on1）を継続し、面談内容の充実を図ります。</li><li>・ 個人投資家向け説明会への参加を継続します。</li><li>・ 第2四半期、通期の決算発表時に開催しているweb決算説明会と動画配信の継続します。</li></ul>                                            |

## 6. IR活動の取り組み、株主還元、その他

### ROE 二桁を目標

当社は、資本収益性を意識し、ROE二桁を目標として掲げております。過去2023年3月期には9.2%であり、今後もこの水準を目指して上記の取り組みを進めてまいります。

### 配当目標

配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として連結配当性向20%以上、安定的かつ継続的な株主還元の拡充として株主資本配当率（DOE）3%程度を当面の目標として実施しております。

### 安定配当

安定配当を意識しており、2023年3月期から2025年3月期までの3年間は継続して年間配当56円を実施いたしました。2026年3月期の年間配当も56円を想定しております。

## 6. IR活動の取り組み、株主還元、その他

### 改善期間中に上場維持基準を満たすことができなかった場合

当社が提出する2026年3月31日時点の株主分布状況表に基づく東京証券取引所の審査の結果、流通株式時価総額基準に適合している状況が確認されなかった場合には、整理銘柄に指定され、当社株式は2026年10月1日に上場廃止となります。

上場廃止となった場合、相対による売買（売買を希望する相手を探し当事者間で直接的に取引すること）を行うことは可能ですが、取引所を介した売買ではなくなりますので流動性が大きく低下し、希望するタイミングでの売買を行いにくくなることが想定されます。

### 引き続き流動性を維持するために

引き続き一定の流動性を維持するために、他の市場区分への再上場、国内の他の取引所への上場などを行うことを考えることができます。

当社は、一定の流動性の維持に向け、諸種の取り組みを行う考えでございます。

## 6. IR活動の取り組み、株主還元、その他

### 株主ならびにステークホルダーのみなさま

今回の東証プライム市場上場維持基準の不適合につきまして、株主の皆様ならびにステークホルダーの皆様にはご迷惑、ご心配をおかけしており、大変申し訳ございません。

今回の上場維持基準不適合は業績不振に起因した株価下落であると当社は認識しています。経営層は、業績不振について大いに反省し、業績改善に向け、より一層の経営努力を重ねていく所存でございます。

現時点におきまして、当社および当社グループ企業の安定経営に特段の影響は生じていないことをお伝えすると共に、金融機関との連携と関係継続をはかり、更なる財務体質の改善を進めております。そして、将来に向けた事業活動を販売と開発の両方において積極的に取り組み、早期に業績改善できるよう努めております。

今後も安心してTOREXグループとビジネスを継続していただけるよう、また当社および当社グループの製品を使い続けていただけるよう、最大の努力を尽くしてまいります。

トレックス・セミコンダクター株式会社  
代表取締役 社長執行役員  
木村 岳史

# Powerfully Small!

常に豊かな知性と感性を磨き、  
市場に適応した価値ある製品を創出し、  
豊かな社会の実現と  
地球環境の保全に貢献するとともに、  
私たちの事業に携わるすべての人々が  
共に繁栄すること



# Appendix

2月7日に半導体製品の世界的IDMメーカーであるPANJIT社と、当社の後工程を行うTVS社の持分の全部または一部を譲渡することを目的とする基本合意書を締結したことを発表。

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 名称                 | PANJIT INTERNATIONAL INC.                                        |
| 所在地                | No. 24, Gangshan N. Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City , Taiwan |
| 売上高<br>(2023年12月期) | 12,707,319千台湾ドル<br>(597億24百万円 / 1台湾ドル=4.7円換算)                    |
| 資本金                | 3,821,149千台湾ドル                                                   |
| 設立年月日              | 1986/05/20                                                       |

PANJIT Global Footprint at a Glance



## トレックスグループのメリット

PANJIT社の製造技術力と、ファブレスメーカーである当社の設計開発力を活かし、相互にシナジー効果を発揮。

パッケージ技術の高度化と全体的な競争力を向上

## Assembly Capacity



※同社IR資料より抜粋

## PWM/PFM制御 36V高耐圧 600mA 降圧DC/DCコンバータ XC9704/XC9705 シリーズ

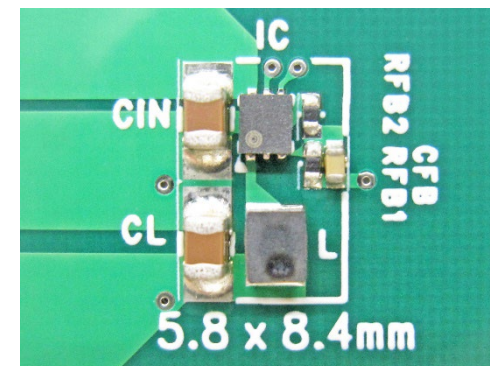
- ・ F-PWM、PWM/PFM自動切換制御
- ・ 同期整流 ドライバ FET内蔵
- ・ 入力電圧範囲 3.0V ~ 36V
- ・ SOT-89-5、USP-6C

### 製品の特長

- ・ 高効率、低リップル電圧
- ・ 発信周波数 : 1.2MHz、2.2MHz
- ・ パワーグッド、UVLO、ソフトスタート外調
- ・ 電流制限、サーマルシャットダウン
- ・ 小型ソリューションを提供

### ターゲットアプリケーション

12V/24Vラインからの小型/低消費が必要な機器  
工場・ビル・施設などのセンサ／セキュリティ機器  
白物家電 : **エアコン等**



36V 600mA 降圧DC/DC  
小型／低消費ソリューション

### << 商談・採用事例 >>

- ・ 家庭用 エアコン
- ・ 業務用 エアコン、リモコン／コントローラ
- ・ 産業用カメラモジュール
- ・ FA用 各種センサー類
- ・ デジタル家電
- ・ 家電製品、白物家電

## PWM/PFM制御 36V高耐圧 600mA 降圧DC/DCコンバータ XCL247/XCL248 シリーズ

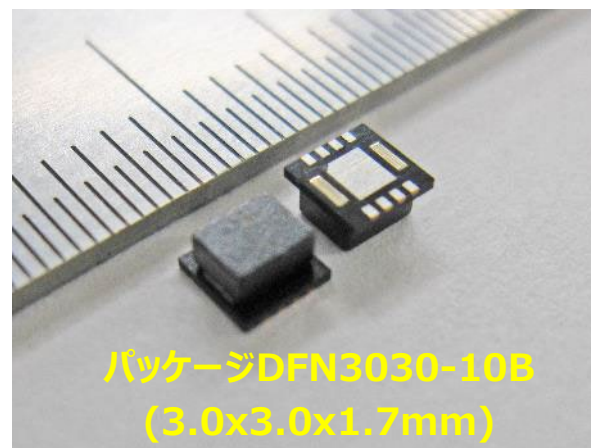
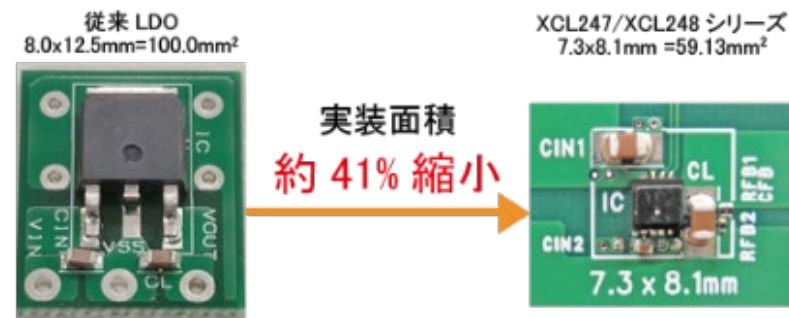
- ・ F-PWM、PWM/PFM自動切換制御
- ・ 同期整流 ドライバ FET内蔵
- ・ 入力電圧範囲 3.0V ~ 36V
- ・ 動作温度範囲 -40℃~105℃

### 製品の特長

- ・ 徹底した小型化で約41%縮小（右図）
- ・ 電力変換の高効率化で発熱を大幅低減（右図）
- ・ ICの上部にコイルを実装する、トレックス独自の  
パッケージ採用で、超小型化を実現

### ターゲットアプリケーション

- ・ 12V/24Vラインからの小型/低消費が必要な機器
- ・ FA機器、産業用センサー、セキュリティシステム、
- ・ 家電製品、高耐圧LDOの置き換え、等々



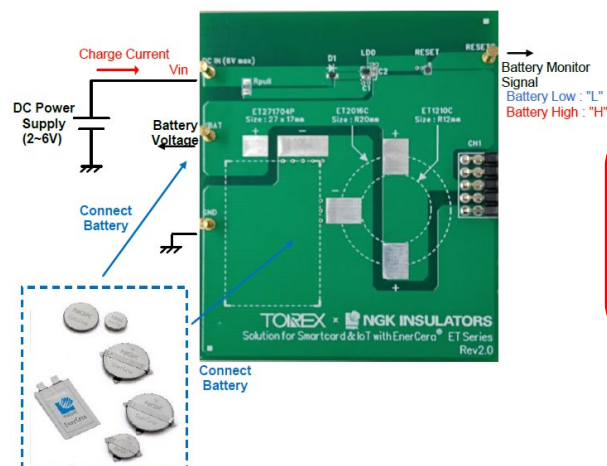
## 動作温度105℃ 定電圧充電リチウム二次電池用 電圧検出器 XC6142シリーズ

### 製品の特長

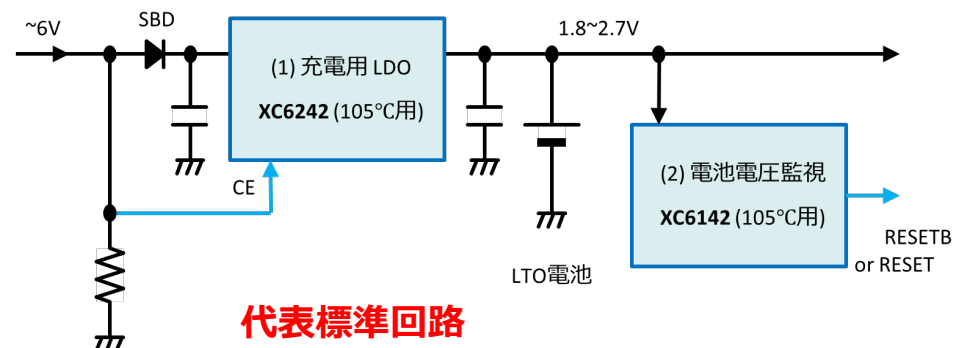
- ・ 2.3V系 小型リチウム二次電池に最適化
- ・ 動作周囲温度：-40℃～105℃

### ターゲットアプリケーション

CV充電対応二次電池の電圧監視  
電気二重層コンデンサの電圧監視

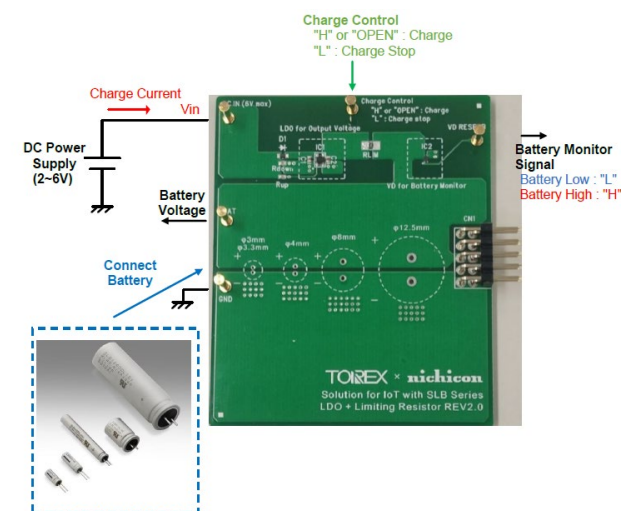


NGK INSULATORS “EnerCera” ET シリーズ用 評価ボード



代表標準回路

採用 リファレンス回路例  
NGK EnerCeraシリーズ  
Nichicon SLBシリーズ



Nichicon SLB シリーズ用 評価ボード

# フェニテックセミコンダクター

ファウンドリ受託

SiC

GaN

GaAs

Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

主要化合物半導体(SiC・GaN・GaAs・Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) デバイスの  
ファウンドリをフレキシブルに受託できるのが、当社の“強み”です

ファウンドリ  
Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

- ✓ 広いバンドギャップ
- ✓ 高い絶縁破壊電界強度
- ✓ 低スイッチング損失
- ✓ 低コスト基板製造の可能性

## Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(酸化ガリウム)とは

酸化ガリウム半導体は、従来のシリコン半導体と比較して、より高い耐圧と低い電力損失を実現できます。ワイドバンドギャップであるため、高温や高周波環境下での動作にも優れています。  
また、他の次世代半導体材料に比べて、基板の製造コストを大幅に削減できる可能性があり、電力変換効率の向上やデバイスの小型化に貢献することが期待されています。

ノベルクリスタルテクノロジー社よりファウンドリを請け負い、  
酸化ガリウムデバイスの試作生産を行なっています

## 生産ノウハウの蓄積

- ✓ 次世代パワー半導体材料として注目されるGa<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の  
ファウンドリにいち早く対応、今後Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>デバイス開発  
・生産の顧客ニーズに応え続けていきます

## ファウンドリ SiC

- ✓ 広いバンドギャップ
- ✓ 高い絶縁破壊電界強度
- ✓ 高い電子移動度
- ✓ 高い熱伝導率
- ✓ 低いオン抵抗

### SiC(炭化ケイ素)とは

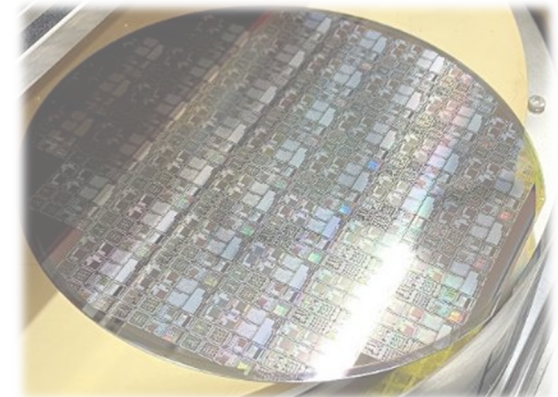
SiC半導体は、シリコンに対し高耐圧・高耐熱性、低損失、高速動作に優れます。これにより、電力変換効率が向上し、デバイスの小型化・軽量化が可能です。

応用分野は多岐に渡り、特に電気自動車のインバータやオンボードチャージャー、鉄道車両の駆動システム、産業機器のパワーコンディショナ、再生可能エネルギー分野などで実用化が進んでいます。高効率な電力制御を実現し、省エネルギー化に貢献する次世代パワー半導体として注目されています。

- ・ 当社SiCファウンドリは、SBD,MOSFET以外にも、要素開発・試作フェーズのものを含めると様々な製品の生産を担っています

### 生産ノウハウの蓄積

- ✓ 今後も、ますます増えていくSiCデバイス生産の顧客ニーズにフレキシブルに応え続けていきます

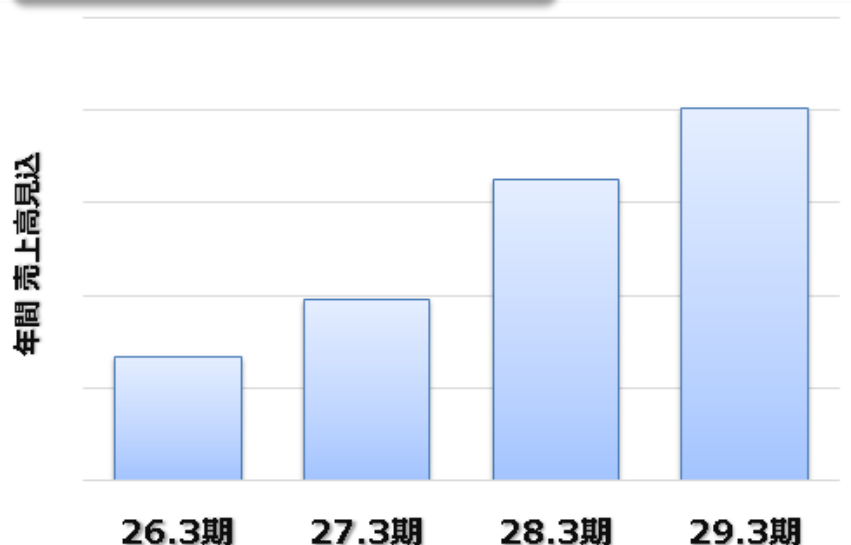


## ファウンドリ受託

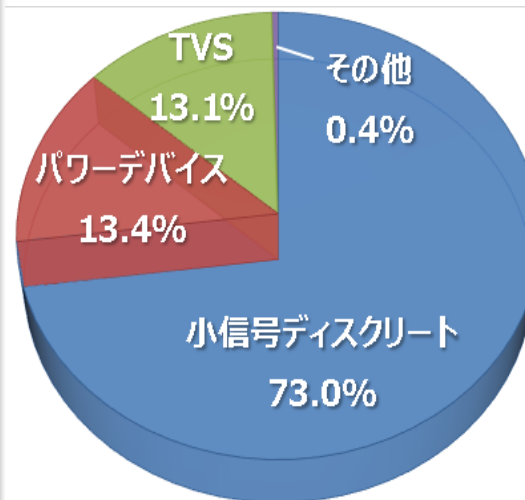
## 新規受注案件

- ✓ 当社主力の一つである小信号ディスクリートを中心に、新規ファウンドリ受託案件が好調です
- ✓ 中華圏の企業がチャイナプラスワン戦略により、ファウンドリ先を国外に移す流れがあり、当社に受託する案件も増加しています

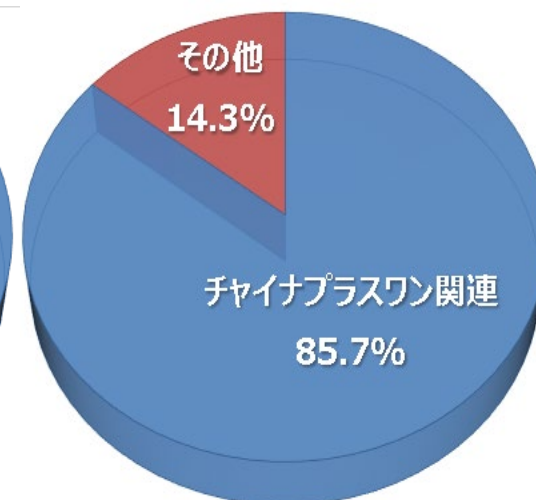
新規受注案件売上高見込み



新規受注案件製品比率



「チャイナプラスワン」関連比率



- ✓ 当社は、地政学的リスク分散、中国におけるコスト上昇、サプライチェーン強靱化などを背景に、各企業のチャイナプラスワン戦略の継続を見込んでおり、今後も成長戦略として関連案件を積極的に取り込んでいきます

## Si製品開発

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す

### Low Vth MOSFET

量産中

- ・製品ラインナップ拡充を継続

### スプリットゲート型MOSFET

60V プロセス開発成功し、狙い特性獲得

- ・26.3期Q3 量産予定
- ・製品ラインナップ拡充を継続

100V

150V

### フィールドストップ型IGBT

650V/40A プロセス開発成功し、狙い特性獲得

- ・26.3期Q2 量産予定
- ・製品ラインナップ拡充を継続

1200V/75A

## SiC製品開発

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す

SBD

自社開発品

量産フェーズ

650V 10A Gen.2,3

650V 20A Gen.2,3

1200V 10A Gen.2,3

650V 6,8,10A Gen.4

✓ 今後も市場要望にスピーディなシリーズ拡充で対応

- ・第2,3,4世代 サンプル提供中/顧客評価中 26.3期Q1量産予定
- ・目標耐圧2200V,3300V品を開発中

MOS FET

自社開発品

1200V 20A Planar/Trench

1200V 40A Planar

1200V 80A Planar

✓電流ラインナップシリーズ展開 試作中

プレーナー型

- ・サンプル提供中/顧客評価中 26.3期Q4量産予定
- ・ベースプロセスライン完成 ラインナップ化を進める  
(1200V 40A /1200V 80A )

トレンチ型

- ・開発中

広島大学 学長定例記者会見

2025.04.24

## 会見概要

当社は、広島大学との共同研究により、高温や高放射線環境下で動作する半導体チップを鹿児島工場で試作製造し、広島大学行われた記者会見で、共同研究の成果として発表しました。

この半導体チップは、SiC(炭化ケイ素)を使用した集積回路で、SiC集積回路の量産ファブでの試作製造は、世界初の取組みとなります。

デバイス設計は主に広島大学が担当し、製造プロセス検討を合同で行い、鹿児島工場6インチ量産ファブで生産しました。

1年弱という短期間で試作ウェハーを完成することができました。今後は幅広い分野での利用を期待し、量産準備を進めます。



広島大学学長定例記者会見の様子

左は広島大学 黒木副所長

右は当社代表取締役 石井(陪席者として登壇)

合同チーム  
Since 2024.5

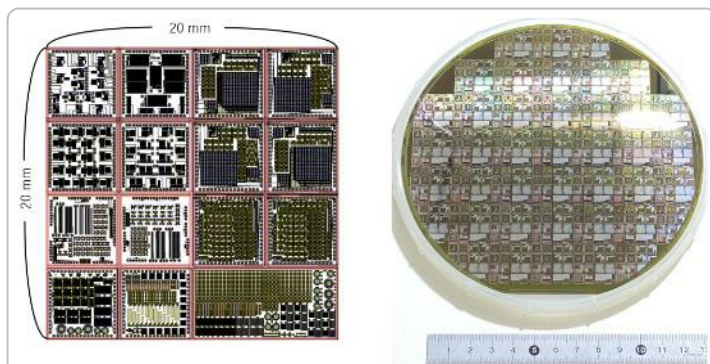


プロセス検討  
回路設計  
デバイス評価

Phenitec  
For Further Growth Together

プロセス検討  
量産Fab試作

## 成果の内容



左は試作製造された集積回路などの図面  
右は試作製造されたSiCウェハー

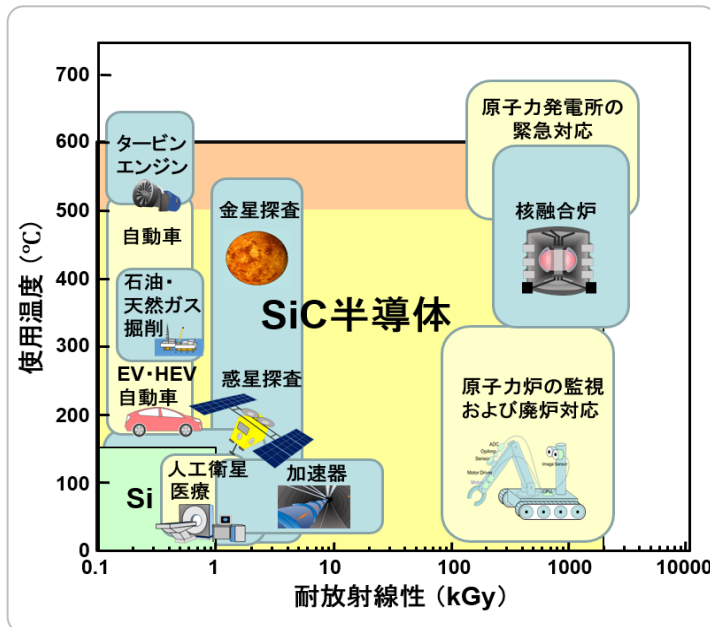
**合同チームにより、新たにSiC集積回路専用の製造プロセスを新たに構築**

**試作製造したSiC集積回路は、500℃の高温や高い放射線量の中でも動作**

シリコン半導体チップの一般的制限 最大温度 150℃、耐放射線性1kGy(キロ・グレイ)程度を越え、半導体の利用領域を大幅に広げる

**応用分野はシリコン半導体が使用できない領域**

EV、原発の廃炉作業、粒子線医療、宇宙開発、次世代原子炉・核融合炉など



**今後は...**

- ✓ SiC集積回路設計・製造の環境整備
- ✓ SiC集積回路の大規模化
- ✓ 応用分野システムメーカーとの連携・ファウン  
ドリ立ち上げの為にSiC集積回路の共通  
プラットフォーム構築へ

**本資料に記載された内容は、2025年6月13日現在において一般的に入手可能な情報と、合理的と判断する一定の前提に基づき、当社が作成したものです。**

**本資料に記載されている当社の中期計画、見通し等に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。**

**実際の業績は、これらの要素により本資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。**

**投資に関するご決定をされる際、本資料のみに全面的に依拠することはお控えいただき、みなさまご自身のご判断でなされるようお願い致します。**